

SOD128-FL



SOD128-FLパッケージは通信機器の小型化を可能にするコンパクトな表面実装パッケージです。Cuクリップ構造により、ワイヤボンディング製品と比較して電気抵抗が低減され、また熱性能が強化されます。

本パッケージは以下の名称でも知られています：

- ▶ M-Flat

Features

- ▶ インダクタンスと抵抗を低減するCuコネクタ
- ▶ 熱特性の強化
- ▶ テストとパッキングサービスを備えたターンキー
- ▶ 環境に優しい材料：Pbフリーめっき、ハロゲンフリーモールド樹脂

New Developments

- ▶ より大型／より高密度のリードフレームストリップ
- ▶ 環境に配慮したPbフリーはんだペースト

Process Highlights

- ▶ めっき加工なしのベアCuリードフレーム
- ▶ インターコネクト：より優れた電気性能と熱性能を追求したCuクリップ技術
- ▶ めっき：100%無光沢Sn
- ▶ マーキング：ペンタイプレーザー

Applications

FLATパッケージは小型と中型サイズの高効率ダイオードのアプリケーションに適しています：

- ▶ ショットキーバリアダイオード（SBD）
- ▶ 整流器ダイオード
- ▶ ツェナーダイオード

Reliability Qualification

Amkorのデバイスは実績のある信頼性の高い部材で製造されています。

- ▶ 前処理条件（全試験前に実施）：Ta = 85°C/Rh = 85%、16 hrs with solder dip, Ta = 265°C, 10s
- ▶ 高温高湿度保管（THS）：Ta = 85°C/Rh = 85%、500 hrs
- ▶ 高温保管（HTS）：Ta = 150°C, 500 hrs
- ▶ プレッシャークッカー：Ta = 121°C/Rh = 100%/P = 2 atm, 144 hrs
- ▶ 温度サイクル：-65~150°C, 300 cycles

Test Service

Amkorはすべてのパワーディスクリート製品においてフルターンキーを提案いたします。MOSFET、バイポーラトランジスター、IGBT、ダイオードおよびレギュレータIC／インテリジェントパワーデバイスを含む様々なパワーデバイスのテストに対応しています。

- ▶ パワーディスクリートテスト：
 - ▷ DC試験
 - ▷ AC試験（スイッチング試験、容量試験、Rg試験等）
 - ▷ L負荷試験（UIS）
 - ▷ 熱抵抗（ ΔVDS 、 ΔmV など）
- ▶ プログラム作成／コンバージョン
- ▶ 不良解析
- ▶ テスト／ハンドリング技術
- ▶ マーキング、外観検査、テープ&リール 一体機

SOD128-FL

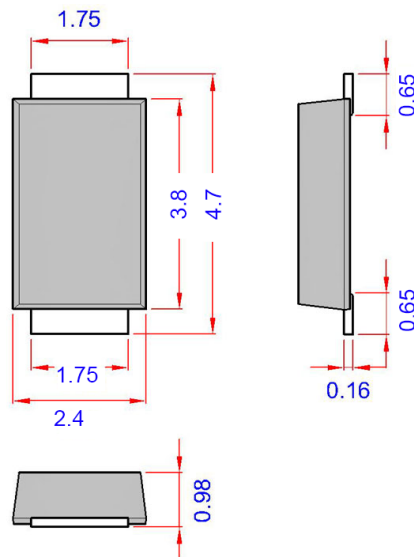
Standard Materials

- ▶ リードフレーム：ベアCu
- ▶ ダイアタッチ：はんだペースト
- ▶ インターコネク：Cuクリップ
- ▶ モールド樹脂：ハロゲンフリー

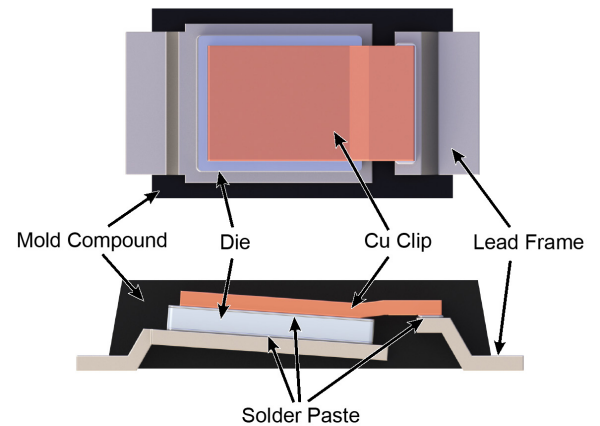
Shipping

- ▶ テープ&リール
 - ▷ 3000pcs/リール
 - ▷ テープ幅 12 mm
 - ▷ リール Φ = 180 mm
- ▶ バーコードラベル
- ▶ ドロップシッ

Package Outline Drawing



Cross-section



詳細についてはamkor.comにアクセス、またはsales@amkor.com までメールをお送りください。

本文中の情報に関して、Amkorは、それが正確であることまたはかかる情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、いかなる保証もいたしません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じたいかなる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によっていかなる特許またはその他のライセンスも許諾しません。本文書は、いかなる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、いかなる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標は、それぞれの会社の財産です。© 2018, Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. DS613C Rev Date: 10/18

